

## 低熔点玻璃粉产品特性及应用领域

序号	产品型号	主要成份	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	封接温度 (°C/min)	DTA		CTE (α)		D50 (um)	应用领域
					Tg	Ts	×10 <sup>-7</sup>	温度范围		
1	YH-F380	PbO-Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -	6.5	380/15	260	285	65-135	50-350	3.5-6.5	1、用于玻璃与玻璃、玻璃与陶瓷、陶瓷与陶瓷、以及陶瓷与金属、可伐等的匹配封接。 2、根据被封接件的匹配要求，膨胀系数及粒度可在一定范围内调整。
2	YH-F420	PbO-Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -	6.5	420/15	310	355	75-115	50-350	3.0-6.0	
3	YH-F440	PbO-ZnO-B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.5	440/15	320	390	85-105	50-350	3.0-6.5	
4	YH-T500	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -ZnO-B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.3	500	370	390	75-95	50-350	≤3	作为高温油墨及浆料的填料，提升膜面硬度、耐高温、抗腐蚀以及绝缘等性能要求。
5	YH-T600	ZnO-B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.5	600	480	500	70-90	50-350	≤3	

